

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信建投证券、中信证券、嘉实基金、交银施罗德基金等近70余家机构
时间	2024年02月26日 12:30-13:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：赵奇 财务负责人、董事会秘书：王伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司2023年度业绩快报预计，实现营业总收入约53.25亿元，同比增长15.59%，其中主营业务收入同比增长24.06%；归属于母公司所有者的净利润约为-19.67亿元；剔除折旧等因素的影响，公司EBITDA（息税折旧摊销前利润）约9.44亿元，同比增长16.63%；公司经营性净现金流约27.30亿元，同比增加13.96亿元，同比增长104.63%。</p> <p>随着市场回暖，公司硅基的IGBT、MOSFET、MEMS等产品需求量稳步回升；碳化硅(SiC)业务作为公司第二业务增长曲线，有望在2024年为公司带来超过10亿元的收入，实现明显的增长。随着公司营收的增长、成本的优化、折旧的逐步消化，公司的盈利状况将逐步改善。</p> <p>问题1：公司亏损额增加的原因是什么？</p> <p>答复：2023年，在全球半导体市场需求疲软的背景下，公司主</p>

	<p>营业收入仍然实现同比增长24.06%。但由于折旧摊销和研发投入增长，公司归母净利润亏损额增加8.79亿元，主要原因如下：</p> <p>第一，2023年公司设备仍处于全折旧期，预计产生的折旧及摊销费用约为33.75亿元，较上年增加了12.93亿元。</p> <p>第二，为加速公司通过技术迭代来实现技术领先，从而支撑公司未来的持续快速发展，2023年公司研发投入继续增大，总投入约15.41亿元，同比增加了7.02亿元。</p> <p>剔除折旧及摊销等因素的影响，公司EBITDA（息税折旧摊销前利润）和经营性净现金流均实现同比增长，经营质量稳步提升。</p> <p>问题2、公司未来的折旧趋势如何？</p> <p>答复：预计2024年公司折旧仍有小幅增加。同时，公司2024年主营业务将实现持续增长，同步也在加强成本优化，我们对2024年亏损额大幅收窄充满信心。</p> <p>问题3、请问公司目前碳化硅（SiC）的主流出货形式是？</p> <p>答复：公司2023年实现了碳化硅的量产，产品类型为平面MOSFET产品，其中90%应用于新能源汽车主驱逆变器。</p> <p>问题4、公司的碳化硅（SiC）业务对收入增长的贡献如何？</p> <p>答复：2023公司已实现碳化硅（SiC）在汽车主驱逆变器的量产，目前已实现月产出5000片以上，公司最新一代的碳化硅（SiC）MOSFET产品性能已达世界领先水平。目前，公司正在建设国内第一条8英寸碳化硅（SiC）器件研发产线，将于2024年通线，预计2024年收入贡献将超过10亿元。长期来看，公司碳化硅（SiC）业务有望在全球达到30%的市场占有率。</p> <p>问题5、公司目前的碳化硅技术水平和量产趋势如何？</p> <p>答复：碳化硅（SiC）MOSFET产品性能好，技术含量高，产品高度集中应用在汽车行业。公司已经突破应用于主驱的平面碳化硅（SiC）MOSFET的技术，并已实现公司最新一代的碳化硅（SiC）MOSFET产品性能达到世界领先水平。同时，公司正在建设的国内第一条8英寸碳化硅（SiC）器件研发产线，也将于2024年通线。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年2月26日